



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽 > DDR4 SO DIMM Sockets



DRAM 类型: 小型 (SO)

堆叠高度: 9.2 mm [.362 in]

模块方向: 直角

位数: 260

中心线 (间距) : .5 mm, 7.3 mm [.02 in]

[所有 DDR4 SO DIMM Sockets \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
DRAM 类型	小型 (SO)

结构特性

钥匙数	1
行数	2
模块方向	直角
位数	260

电气特征

DRAM 电压	1.2 V
---------	-------

信号特征

SGRAM 电压	1.2 V
----------	-------

主体特性

固定柱位置	两端
固定柱材料	不锈钢
插销材料	高温热塑塑料



模块钥匙类型	右偏移
弹射器类型	锁定
弹射器位置	两端
连接器外形	高

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
端子底板材料	镍
内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接触部电镀材料	镀金

端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定类型	焊钉
接合对准类型	反向键控
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.5 mm, 7.3 mm[.02 in]

尺寸

堆叠高度	9.2 mm[.362 in]
行间距	8.2 mm[.322 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

封装数量	500
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [DDR4 DIMM](#)



DIMM 插槽(25)



SO DIMM 插槽(39)

客户还购买了



TE 产品编号3-1617029-6
HFW1131K05M = M39016/6-207M



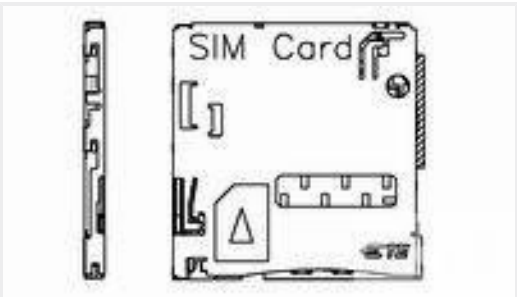
TE 产品编号CAT-D33047-SO1339
DDR4 SO DIMM Sockets



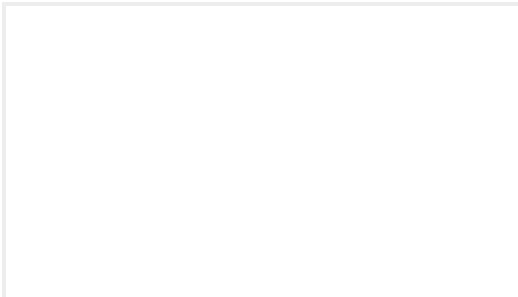
TE 产品编号2178148-1
Kit, CLOUDSPLITTER, Un-Shielded Cbl



TE 产品编号3-641208-6
06P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号2229333-2
PUSH-PUSH MICRO SIM
CONNECTOR SMT-2 TYPE



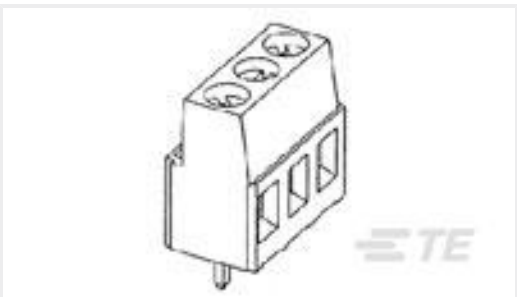
TE 产品编号2373624-4
Rcpt Assy,Diecast Housing,PCIe Gen 5



TE 产品编号826656-3
3P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号2314979-1
HARD WARE KITS WITH HS&LP,CFP2
1X1



TE 产品编号796949-4
4 POS TERMI-BLOK PCB MOUNT

文档

产品图纸

DDR4 SODIMM 260P 9.2H RVS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2309414-1_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2309414-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2309414-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本